

软硬结合板:

什么时候会选择软硬结合板

FPC (软板) 与 PCB (硬板) 的诞生与发展, 催生了软硬结合板这一新产品。

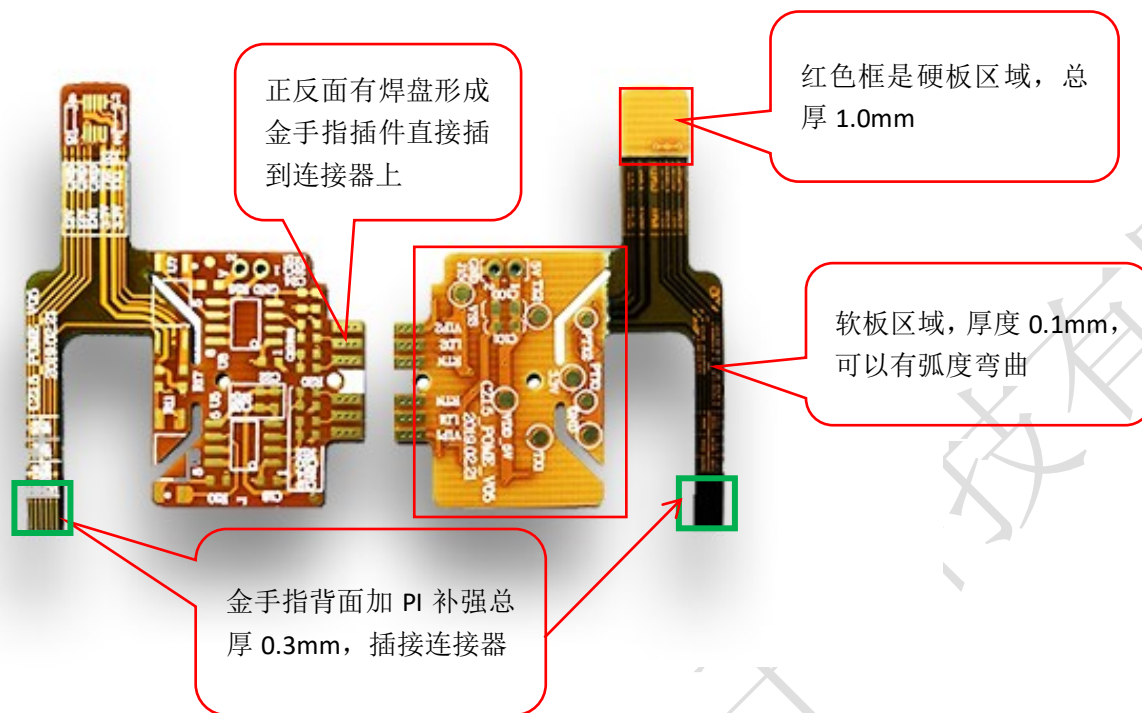
因此软硬结合板就是柔性线路板与硬性线路板, 经过压合等工序, 按相关工艺要求组合在一起, 形成的具有 FPC 特性与 PCB 特性的线路板。

优点: 具有 PCB 和 FPC 两方面优秀特性, 既可以对折, 弯曲, 减少空间, 又可以焊接复杂的元器件。同时相比排线有更长的寿命, 更加可靠的稳定性, 不易

折断氧化脱落, 对于提升产品性能有很大帮助。

可以生产 1 至 12 层软硬结合板, 厚度: 0.4 至 2.5mm, 铜厚有 1/3、0.5、1、2 OZ 可以选择, 表面处理: 沉锡/电锡/沉金/镀金/镍钯金

可以做盲埋孔, 可以做单端和差分阻抗。



产品类别：2层软硬结合板（结构：第1层软板+第2层硬板）

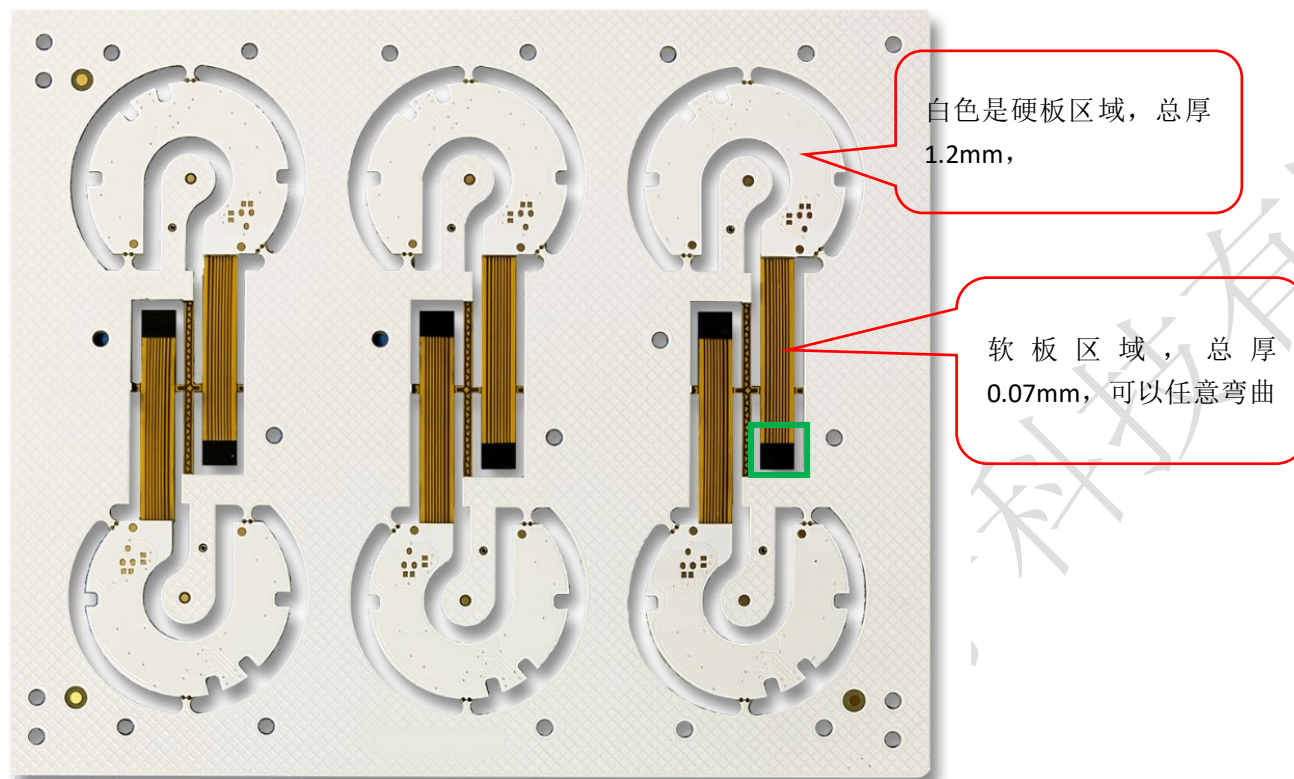
基本参数：软板处：0.5 OZ CU 1mil PI 黄色覆盖膜 硬板处：0.5OZ CU FR4 阻焊层：黄油

线宽/线距：0.15mm/0.15mm，表面处理：沉金 2u"

外形公差：±0.05mm

FPC 处产品厚度：0.11mm，金手指+PI 补强总厚度：0.3mm，PCB 板处厚度：1.0mm

其它：用于智能家居行业



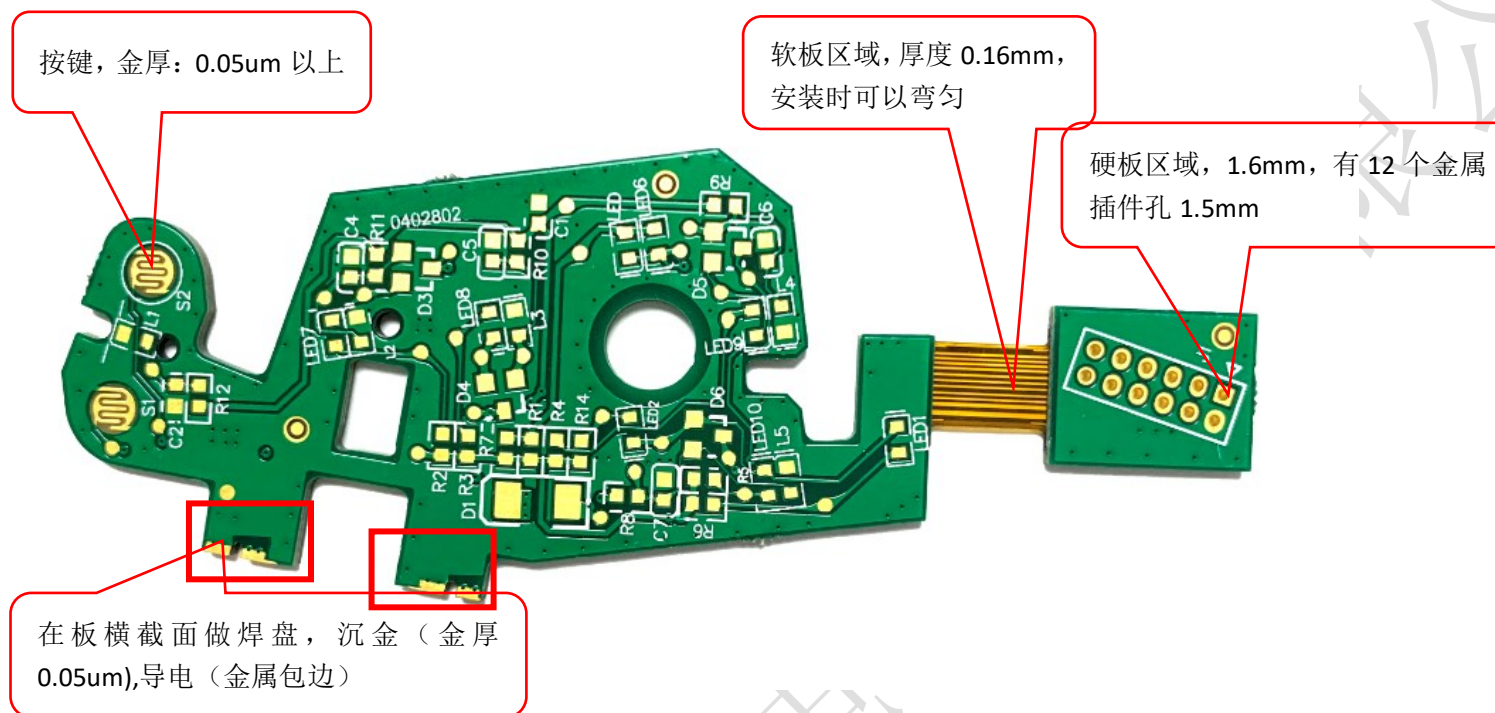
产品类别：2层刚柔结合板（结构：第1层软板+第2层硬板）

基本参数：软板处：0.5 OZ CU 0.5mil PI 黄色覆盖膜 硬板处：0.5OZ CU FR4 阻焊层：白油

线宽/线距：0.15mm/0.15mm，表面处理：沉金 2u,金手指外形公差：±0.05mm

FPC 处产品厚度：0.07mm，金手指+PI 补强总厚度：0.3mm，PCB 板处厚度：1.2mm

其它：AI 智能穿戴



产品类别: 4层刚柔结合板 (结构: 第1层硬板+第2、3层软板+第4层硬板)

基本参数: 软板处: 0.5 OZ CU 1mil PI (无胶材料) 黄色覆盖膜 硬板处: 0.5OZ CU FR4 高Tg170 阻焊层: 绿油

线宽/线距: 0.15mm/0.15mm, 表面处理: 沉金 2u, 外形公差: ±0.1mm

FPC 处产品厚度: 0.16mm, PCB 板处厚度: 1.6mm

其它: 用于汽车行业的挂挡器,在板横截面做焊盘, 电金 (金厚 2u"),金属包边, 可以导电, 有按键触摸, FPC/软板处装机时可以弯曲。



产品类别：4层刚柔结合板（结构：第1层硬板+第2、3层软板+第4层硬板）

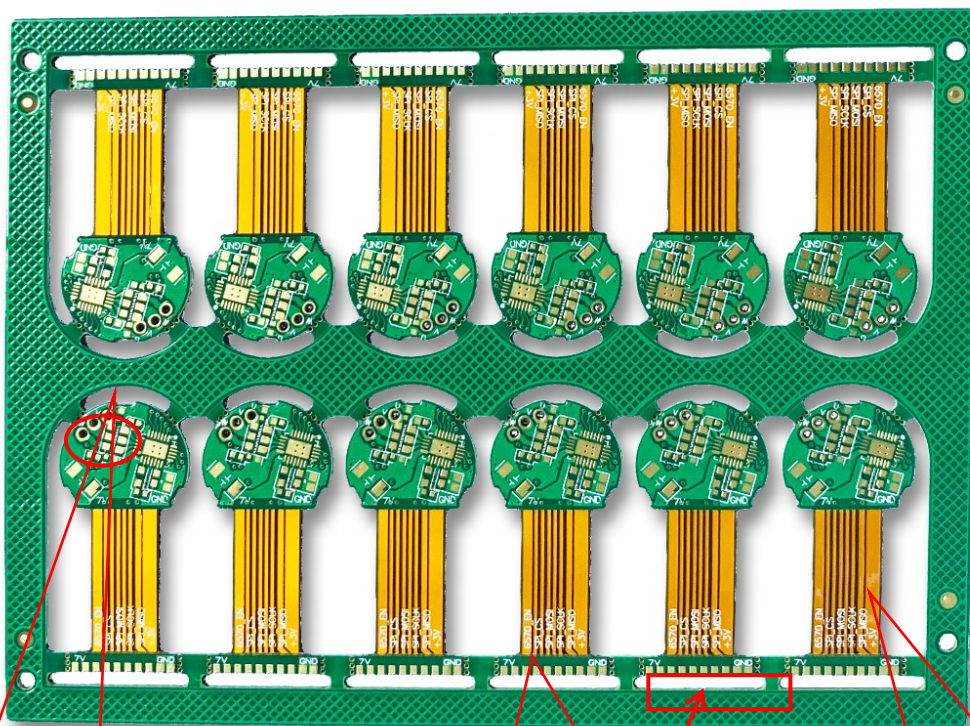
基本参数：软板处：0.5 OZ CU 1mil PI（无胶材料）黄色覆盖膜 硬板处：0.5OZ CU FR4 高Tg170 阻焊层：绿油

线宽/线距：0.15mm/0.15mm，表面处理：沉金 2u"

外形公差：±0.1mm

FPC 处产品厚度：0.16mm，PCB 板处厚度：1.2mm

其它：用于医疗行业口腔设备。



硬板区域, 总厚 1.0mm, 3 个 2.0mm 插件孔

焊盘都有半孔 / 半孔工艺, 硬板区域宽度只有 4.5mm

软板区域 (第 2、3 层走线是软板区域) 0.5OZ CU 厚度 0.16mm

产品类别: 4层刚柔结合板 (结构: 第1层硬板+第2、3层软板+第4层硬板)

基本参数: 软板处: 0.5 OZ CU 1mil PI (无胶材料) 黄色覆盖膜 硬板处: 0.5OZ CU FR4 高Tg170 阻焊层: 绿油

线宽/线距: 0.15mm/0.15mm, 表面处理: 沉金 2u", 外形公差: ±0.1mm

FPC 处产品厚度: 0.16mm, PCB 板处厚度: 1.6mm

其它: 用于医疗行业口腔



广州宏澈电子科技有限公司

专业生产 FPC 和软硬结合板

hcsales@hongchekj.com www.hongchekj.com

想了解更多柔性线路板 (FPC)和软硬结合板的材料和工艺可以随时沟通。

广州宏澈电子科技有限公司

联系电话: 020-38331310

邮箱: hcsales@hongchekj.com

网址: www.hongchekj.com

联系人: 钟倩 (13450438977)

广州宏澈电子科技有限公司